(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2007 年5 月31 日 (31.05.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/060803 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/683 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2006/321223

(22) 国際出願日: 2006 年10 月25 日 (25.10.2006)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2005-338920
2005 年11 月24 日 (24.11.2005) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 野中英明 (NONAKA, Hideaki) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 小林賢治 (KOBAYASHI, Kenji) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 山口義雄 (YAMAGUCHI, Yoshio); 〒2060034 東京都多摩市鶴牧１丁目４番１７号 いずみビル８Ｆ Tokyo (JP).

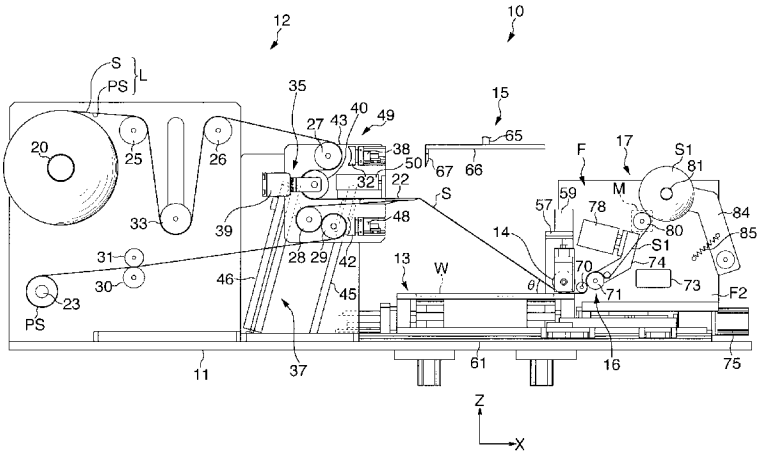
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

[続葉有]

(54) **Title:** SHEET ADHERING APPARATUS AND SHEET ADHERING METHOD

(54) 発明の名称: シート貼付装置及び貼付方法



(57) **Abstract:** A sheet adhering apparatus (10) is provided with a sheet feeding unit (12) for feeding an adhesive sheet (S) to a position facing a plane of a semiconductor wafer (W), and a pressing roller (14) for adhering the adhesive sheet (S) on the wafer (W) by pressing the adhesive sheet (S). The sheet feeding unit (12) includes a tensile force measuring means (35) for measuring a tensile force of the adhesive sheet (S) between the sheet feeding unit (12) and the pressing roller (14) and an adhering angle maintaining means (37) having a feeding head (49) for maintaining an attaching angle (θ). After adjusting the tensile force by measuring the tensile force just before adhering the adhesive sheet (S), the feeding head (49) is brought down in proportion to a moving quantity of the pressing roller (14) to maintain the adhering angle (θ), and the tensile force is kept constant.

[続葉有]

WO 2007/060803 A1

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

半導体ウエハ（W）の面に臨む位置に接着シート（Ｓ）を繰り出すシート繰出ユニット（１２）と、接着シート（Ｓ）を押圧して当該接着シート（Ｓ）をウエハ（W）に貼付する押圧ローラ（１４）とを備えてシート貼付装置（１０）が構成されている。シート繰出ユニット（１２）は、当該シート繰出ユニット（１２）と押圧ローラ（１４）との間の接着シート（Ｓ）の張力を測定する張力測定手段（３５）と貼付角度（θ）を維持する繰出ヘッド（４９）を備えた貼付角度維持手段（３７）とを含む。接着シート（Ｓ）の貼付直前に張力を測定して調整した後、押圧ローラ（１４）の移動量に比例するように繰出ヘッド（４９）を下降させることで貼付角度（θ）が維持されて張力が一定に保たれる。